[Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by erratical manufacturing data, mistakes in process data input, a broken drill bit or a defective die (Manufacturing data preparation, drilling and punching processes)



[コメント] 余分穴により穴数が増 えている例 顕微鏡倍率×

【注释】

由于有多余的孔,孔的 数量增加 显微镜倍率 ×

[Coments]

Excessive number of holes caused by superfluous hole. Magnification: ×

6-3-2-5 穴加工位置違い/孔位的错误 / Wrong hole position

【特徴】穴やスリットの位置が仕様と異なっている 状態の欠陥

【特征】孔或者槽口的位置与标准不相同的缺陷。

[Characteristics] The position of a hole or a slit is different from that specified.

【原因・判断ポイント・発生工程】設計データ不良 により出来たもの(設計データ作成段階、穴明け工 程)

【原因、判断要点、发生工序】设计数据有错误所引起的(设计数据的编辑阶段、钻孔工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] The defect is caused by erratical manufacturing data (Manufacturing data preparation and drilling processes)



基準穴、部品位置決め 穴位置が右側にズレて いる

顕微鏡倍率×

【注释】

基准孔、元件定位孔偏 移到右侧。 显微镜倍率 ×

[Coments]
Fiducial hole position
mark is displaced to
right
Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×

显微镜倍率×

[Coments] Magnification: ×

6-3-2-6 **余分**穴/多余孔/Extra hole

【特徴】不必要な穴が明いている状態の欠陥

【特征】钻出了不必要的孔的缺陷。

[Characteristics] An unnecessary hole is drilled.

【原因・判断ポイント・発生工程】設計データ不良 により出来たもの(設計データ作成段階、穴明け工 程)



【コメント】 顕微鏡倍率×

显微镜倍率×

[Coments]
Magnification: ×